

FQ 2,54D/ 30-SH-0-BT - Buchsenleiste



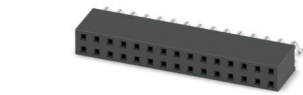
1156905

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1156905>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



SMD-Sockelleiste, Nennstrom: 3 A, Prüfspannung: 500 V AC, Polzahl: 30, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Buchse, Montage: SMD-Löten



Ihre Vorteile

- Zuverlässige mechanische und elektrische Verbindungen durch doppelseitiges Kontaktsystem
- Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
- Klares und kostenoptimiertes Design
- Geeignet für eine Vielzahl von Applikationen
- Gestapelte, koplanare oder orthogonale Leiterplattenverbindungen erlauben höchste Flexibilität im Gerät

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1156905
Verpackungseinheit	130 Stück
Mindestbestellmenge	130 Stück
Verkaufsschlüssel	AB
Produktschlüssel	AAXABA
GTIN	4063151159771
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,4 g
Zolltarifnummer	85366930
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zum Betrieb	Die zulässige Spannung im Betrieb ergibt sich in Abhängigkeit von der Anwendung unter Berücksichtigung der Luft- und Kriechstrecken im Rahmen der Isolationsanforderungen gemäß IEC 60664-1.
---------------------	--

Artikeleigenschaften

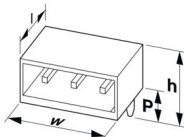
Produkttyp	SMD-Sockelleiste
Produktfamilie	FQ 2,54D/...-SH
Polzahl	30
Rastermaß	2,54 mm
Anzahl der Reihen	2
Pinlayout	Lineare Pad-Geometrie
Elektrische Eigenschaft	geschirmt

Elektrische Eigenschaften

Eigenschaften

Nennstrom I_N	3 A (bei 20 °C 80-polig)
Durchgangswiderstand	20 mΩ
Prüfspannung	500 V AC IEC 60512-4-1:2003-05
Elektrische Eigenschaft	geschirmt

Maße

Maßzeichnung	
Rastermaß	2,54 mm
Breite [w]	38,5 mm
Höhe [h]	5 mm
Länge [l]	15,74 mm
Bauhöhe	5 mm

Anwendung

Kontaktüberdeckung	0,4 mm
Überstecklänge	1,3 mm

Leiterplatten-Design

Pad-Geometrie	1,04 x 1,32 mm
---------------	----------------

Materialangaben

Materialangaben - Kontakt

Hinweis	WEEE/RoHS konform, whisker-frei nach IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material Kontakt	Cu-Legierung
Oberflächenbeschaffenheit	Selektivbeschichtung
Metalloberfläche Kontaktbereich (Deckschicht)	Gold (Au)
Metalloberfläche Kontaktbereich (Zwischenschicht)	Nickel (Ni)
Metalloberfläche Lötbereich (Deckschicht)	Zinn (Sn)

Materialangaben - Gehäuse

Farbe (Gehäuse)	schwarz (9005)
Isolierstoff	PA
Isolierstoffgruppe	I
CTI nach IEC 60112	600
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Steckverbinder

Anschluss 1

Isolierstoff	PA
CTI nach IEC 60112	600

Elektrische Prüfungen

Thermische Prüfung | Prüfgruppe C

Prüfspezifikation	IEC 60512-5-2:2002-02
Geprüfte Polzahl	80

Isolationswiderstand

Prüfspezifikation	IEC 60512-3-1:2002-02
Isolationswiderstand benachbarte Pole	> 1 GΩ

Luft- und Kriechstrecken |

Isolierstoffgruppe	I
Mindestwert der Luft- und Kriechstrecke	0,4 mm

Mechanische Prüfungen

Steck- und Ziehkräfte

Ergebnis	Prüfung bestanden
Anzahl der Zyklen	100
Steckkraft je Pol ca.	2,9 N
Ziehkraft je Pol ca.	2,9 N

Sichtprüfung

Prüfspezifikation	IEC 60512-1-1:2002-02
Ergebnis	Prüfung bestanden

Maßprüfung

Prüfspezifikation	IEC 60512-1-2:2002-02
Ergebnis	Prüfung bestanden

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Lebensdauerprüfung

Prüfspezifikation	IEC 60512-9-1:2010-03 (in Anlehnung)
Durchgangswiderstand R_1	20 m Ω
Durchgangswiderstand R_2	30 m Ω
Steckzyklen	100
Isolationswiderstand benachbarte Pole	> 1 G Ω

Vibrationsprüfung

Prüfspezifikation	IEC 60068-2-6:2007-12
Frequenz	10 - 55 - 10 Hz
Sweep-Geschwindigkeit	1 Oktave/min
Amplitude	1,52 mm
Beschleunigung	181 m/s ²
Prüfdauer je Achse	2 h
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 100 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 100 °C

Montage

Montageart	SMD-Löten
Pinlayout	Lineare Pad-Geometrie

Verarbeitungshinweise

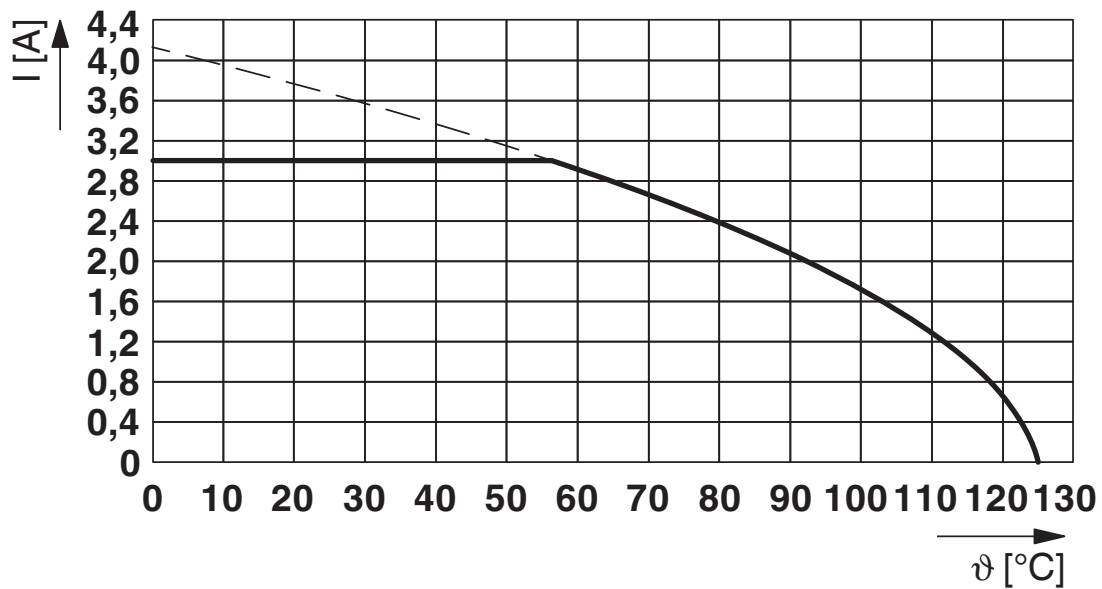
Prozess	Reflowlötung
Moisture Sensitive Level	MSL 1
Classification Temperature T_c	260 °C

Verpackungsangaben

Verpackungsart	Stangenmagazin
----------------	----------------

Zeichnungen

Diagramm



Typ: FQ 2,54D/...-SH-0-BT mit FQ 2,54D/...-PH-1-BT

FQ 2,54D/ 30-SH-0-BT - Buchsenleiste



1156905

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1156905>

Zulassungen

 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1156905>

 cULus Recognized Zulassungs-ID: E118976				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	30 V	3 A	-	-

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 10.0	EC002637
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,386 kg CO2e
---------	---------------